

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022-011

广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于公司及子公司融资业务进展公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币8亿元的授信额度。具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经2020年度股东大会审议通过。

近日，平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）为公司追加授信金额2,000万元，期限12个月，由实控人赵积清先生与惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。

公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

企业名称：平安银行股份有限公司

统一社会信用代码：91440300192185379H

注册资本：1142489.4787万人民币

成立日期：1987年12月22日

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号

经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金进口业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。（《保险兼业代理业务许可证》有效期至2015年5月1日）

三、累计综合授信额度

如上述交易完成后，公司及子公司已签署的融资协议涉及的累计融资金额（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人的融资额度；不含已单独经董事会、股东大会审议通过的中国银行与农业银行的 1.7 亿元银团贷款额度）为人民币 79,040.00 万元，涉及的累计担保为人民币 44,040 万元（不含已单独经董事会、股东大会审议通过的与中国银行、农业银行银团贷款有关的 1.7 亿元担保额度）。本次融资事项在 2020 年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜，无需再提交董事会或股东大会审议。

四、交易目的及对公司的影响

公司进行项目融资交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

平安银行综合授信额度合同

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日